

研究評価委員会

「立体構造新機能集積回路(ドリームチップ)技術開発」 (事後評価) 第1回分科会

日 時：平成25年6月28日(金) 10:20~17:25
場 所：大手町サンスカイルームD室(朝日生命大手町ビル27階)

議事次第

<公開の部>

- | | | |
|---|-------------|-------|
| 1. 開会、分科会の設置、資料の確認 | 10:20~10:30 | (10分) |
| 2. 分科会の公開について | 10:30~10:35 | (5分) |
| 3. 評価の実施方法と評価報告書の構成について | 10:35~10:40 | (5分) |
| 4. プロジェクトの概要説明(公開) | | |
| 4.1 「事業の位置づけ・必要性」及び「研究開発マネジメント」 | 10:40~10:50 | (10分) |
| 4.2 「研究開発成果」及び「実用化・事業化の見通し
及び取り組みについて」 | 10:50~11:05 | (15分) |
| 4.3 質疑 | 11:05~11:45 | (40分) |

(昼食)

11:45~12:35 (50分)

<非公開の部>非公開資料取扱いの説明

12:35~12:40 (5分)

5. プロジェクトの詳細説明

- | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|
| 5.1 多機能高密度三次元集積化技術 | 12:40~13:40 | (60分) |
| 5.1.1 次世代三次元集積化設計技術の研究開発 | | [説明30分、質疑30分] |
| 5.1.2 次世代三次元集積化のための評価解析技術の研究開発 | | |
| 5.1.3 次世代三次元集積化の共通要素技術開発と設計基準策定 | | |

(休憩)

13:40~13:50 (10分)

5.2 実用化・事業化の見通し及び取り組みについて

5.2.1 デンソー

13:50~14:15 (25分)
[説明13分、質疑10分、入替2分]

5.2.2 富士通

14:15~14:40 (25分)
[説明13分、質疑10分、入替2分]

5.2.3 ローム/ラピスセミコンダクタ

14:40~15:05 (25分)
[説明13分、質疑10分、入替2分]

5.2.4 日立製作所

15:05~15:28 (23分)
[説明13分、質疑10分]

(休憩)

15:28~15:38 (10分)

5.2.5 日本 I B M	15:38 ~ 16:03 (25 分) [説明 13 分、質疑 10 分、入替 2 分]
5.2.6 ルネサスエレクトロニクス	16:03 ~ 16:28 (25 分) [説明 13 分、質疑 10 分、入替 2 分]
5.2.7 エルピーダメモリ	16:28 ~ 16:53 (25 分) [説明 13 分、質疑 10 分、入替 2 分]
6. 全体を通しての質疑	16:53 ~ 17:10 (17 分)
<公開の部>	
7. まとめ・講評	17:10 ~ 17:20 (10 分)
8. 今後の予定	17:20 ~ 17:25 (5 分)
9. 閉会	17:25

以 上